

HXP200 Series / 1735・2535・3445・4058

- AMI2400Xシリーズの各部をリファインし、後継新モデルとしてリリース ※AMI2400Xシリーズは今後も継続して販売する予定です。
- 4サイズのアンテナ一体型RFIDリーダライタモジュール（3445は新サイズ）
- ミドルクラスのRFパワーで実用的な通信距離を確保
- LPCD（低消費電力近接カード検出）機能の他、フルパワー間欠動作のポーリング機能による低消費電力機能を実現
- NFCのすべてのIC（NFC-F, -A, -B, -V）に対応するほか、ISO18000-3 mode3にも対応
- FeliCa Lite-SのMAC認証機能に対応
- ISO15693、ISO18000-3 mode3は輻輳制御（アンチコリジョン）に対応
- IICによるディジーチェーン接続が可能（オプション）
- GPIOポートを搭載し、LED等の制御が可能
- 海外電波法にも対応可能な高周波設計（別途認証は必要）FCCモジュール認証可能モデルあり（オプション）

本体仕様

No.	項目	仕様				
1	中心周波数	13.56MHz				
2	伝送速度	FeliCa	212Kbps			
		ISO14443	106Kbps、212Kbps、424Kbps、848Kbps			
		ISO15693	26Kbps、52Kbps			
		ISO18000-3M3	424Kbps			
3	対応規格	ISO14443 Type-A/Type-B, FeliCa (ISO18092), ISO15693, ISO18000-3mode3				
4	適合カード	FeliCa	RC-S100 / FeliCa Lite-S / RC-S888 / RC-S860			
		ISO14443	MIFARE Classic 1K・4K / Ultralight / DESfire / N-Tag			
		ISO15693	I-CODE-SLIX等のI-CODE-SLIシリーズ / NTag-Vシリーズ / Tag-itシリーズ			
		ISO18000-3M3	I-CODE-ILT(M)			
5	電波法区分	誘導式読み書き通信設備				
6	動作温度	-20°C ~ 70°C				
7	保存温度	-30°C ~ 80°C				
8	保存・動作湿度	30%RH ~ 80%RH(結露無きこと)				
9	RF本体基板	HXP200 / 1735	17mm×35mm×4mm (接続コネクタ含む)			
		HXP200 / 2535	25mm×35mm×4mm (接続コネクタ含む)			
		HXP200 / 3445	34mm×45mm×4mm (接続コネクタ含む)			
		HXP200 / 4058	40mm×58mm×4mm (接続コネクタ含む)			
10	RF本体基板重量	約5g以下				
11	接続アンテナ	モジュール内に内蔵				
12	供給電源	DC5.0V ±5%				
13	読取距離 (mm)	FeliCa(RC-S100)	MIFARE Classic 1K	I-CODE-SLIX	Type-B (IC運転免許証)	
		HXP200 / 1735	45	47	92	27
		HXP200 / 2535	55	62	108	35
		HXP200 / 3445	65	70	130	47
		HXP200 / 4058	75	83	142	55
※ICタグの種類や設置環境（金属の有無、ノイズ）等で変動します ※カードサイズICタグによる参考値になります						
14	上位インタフェース	調歩同期式シリアルインタフェース（UART 3.3V） または IIC				
15	接続用コネクタ	上位ホスト接続用：JST製 SM06B-SRSS-TB / 拡張用：JST製 SM04B-SRSS-TB				
16	消費電流 (GPIO不使用時)	待機時：17mA以下 (RF-OFF状態)	最大値（無変調RF出力時） 自由空間：90mA以下 金属近接：235mA以下	LPCD動作時：平均0.38mA以下 間欠ポーリング：平均0.63mA以下 (ISO15693ポーリング時)		

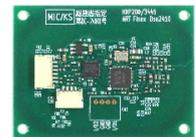
モジュールイメージ



HXP200/1735



HXP200/2535



HXP200/3445



HXP200/4058

評価キット

本製品には、WindowsPCですぐにお使いいただける「評価キット」をご用意しております。PCと接続するインタフェースは、USBとRS-232Cから選択ください。

- ・実際にご使用になるICカード又はICタグで動作の確認をいただきたいうえでご使用下さい。
- ・本製品は組込み用のモジュールです。ケース入りや上位インタフェースにつきましては、ご相談ください。
- ・本仕様は2025年6月現在の広告です。仕様及び外観は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- ・本製品を国外で使用する場合、仕向国の電波法の認証が別途必要となります。
- ・MIFARE、DesFIREはNXP Semiconductors N.V.社の商標又は登録商標です。・FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- ・本製品はRoHS指令（欧州環境規制）に対応しております。



製品概要書
インタフェース仕様書
評価用アプリケーション

Ver1.00 2025年6月現在